

承 认 书

客户名称：_____

物料编码：_____

产品型号：JK-1615幻彩-MW5

版本编号：1.30

日 期：2024-04-12

产品描述：

- 贴片1615幻彩
- 胶体颜色：白色透明胶体



承 认 签 章

承 认 签 章		
编制	审核	核准

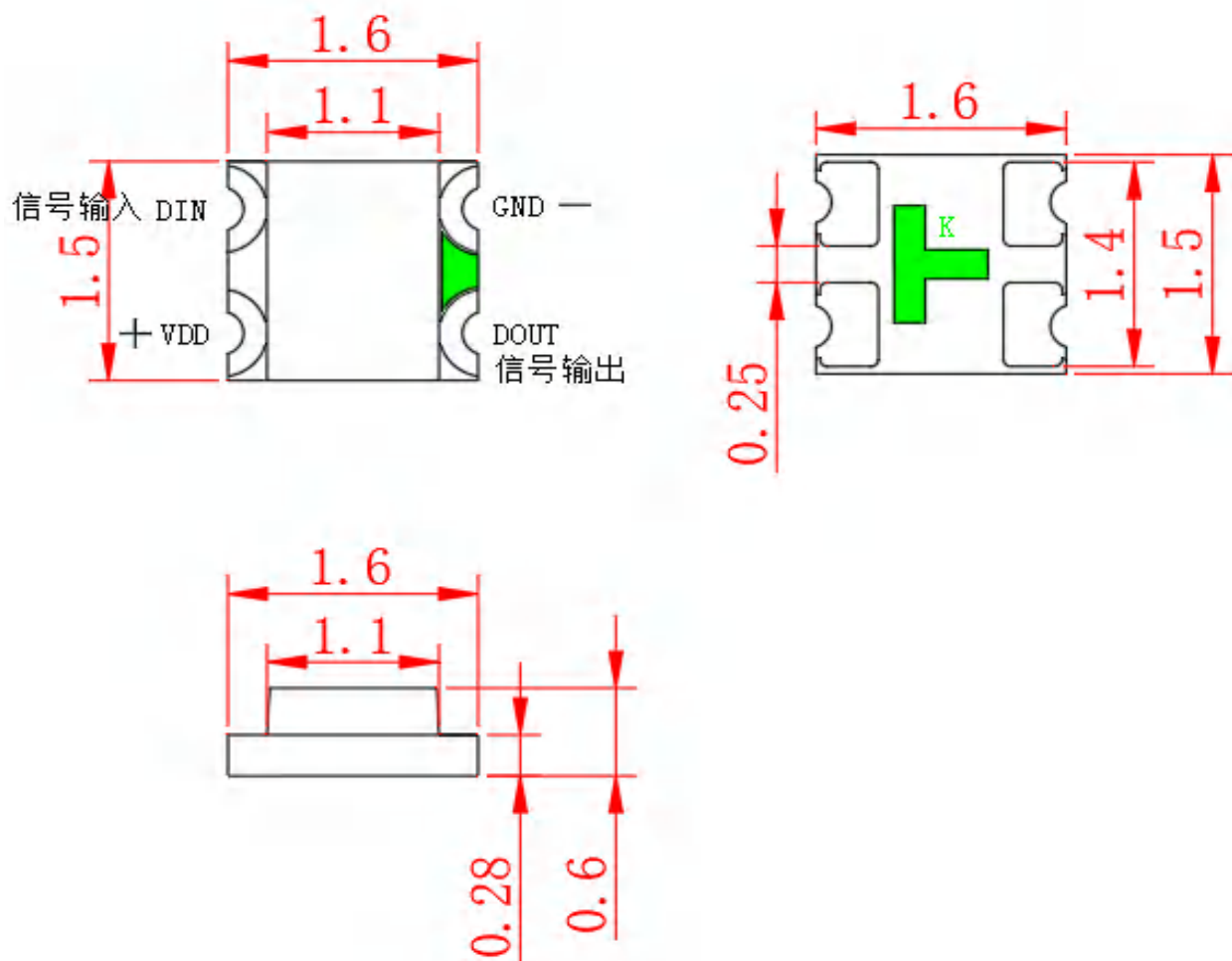
客 户 确 认

客 户 确 认		
确认	审核	核准

一、产品描述:

- 外观尺寸(L/W/H) : 1.6×1.5×0.6 mm
- 颜色: R/G/B幻彩
- 胶体: 透明平面胶体
- EIA规范标准包装
- 环保产品, 符合ROHS规定
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

二、外观尺寸:

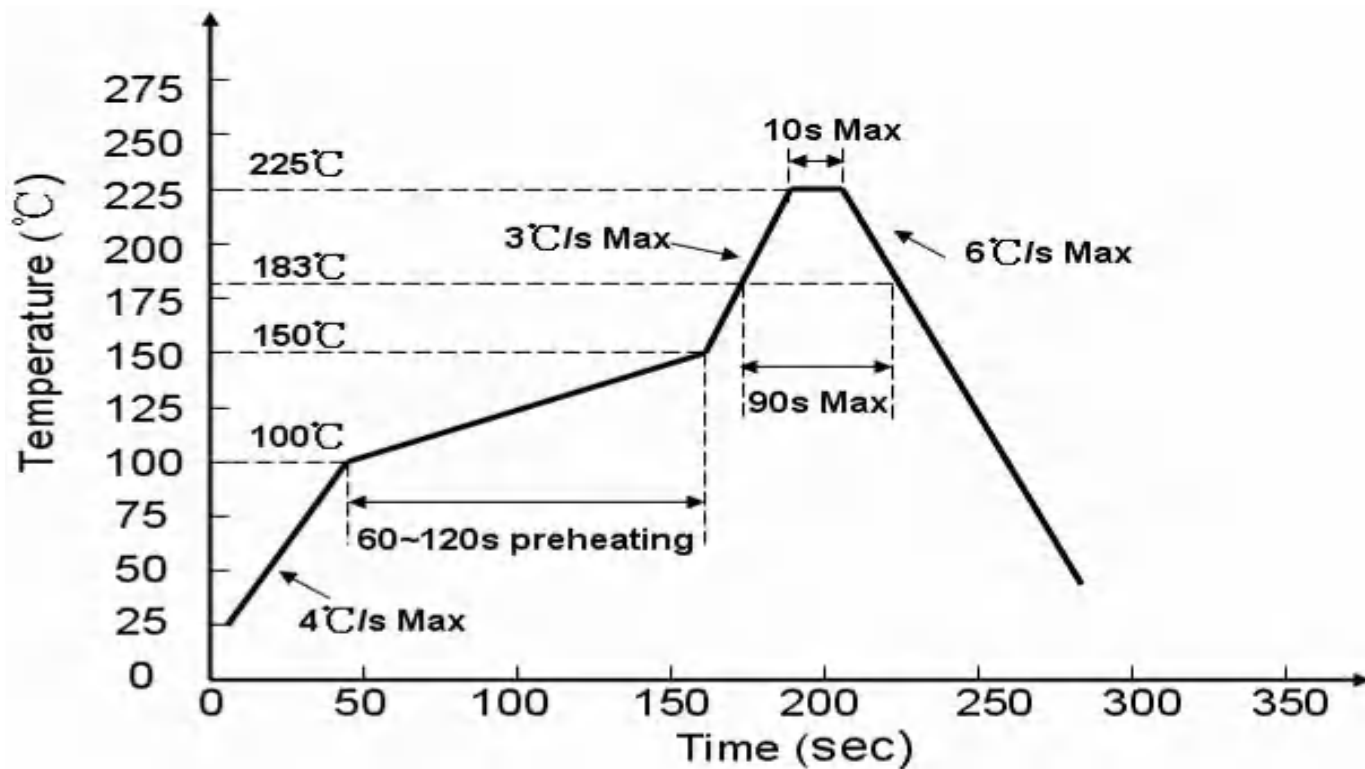


注: 1、单位: 毫米 (mm)。

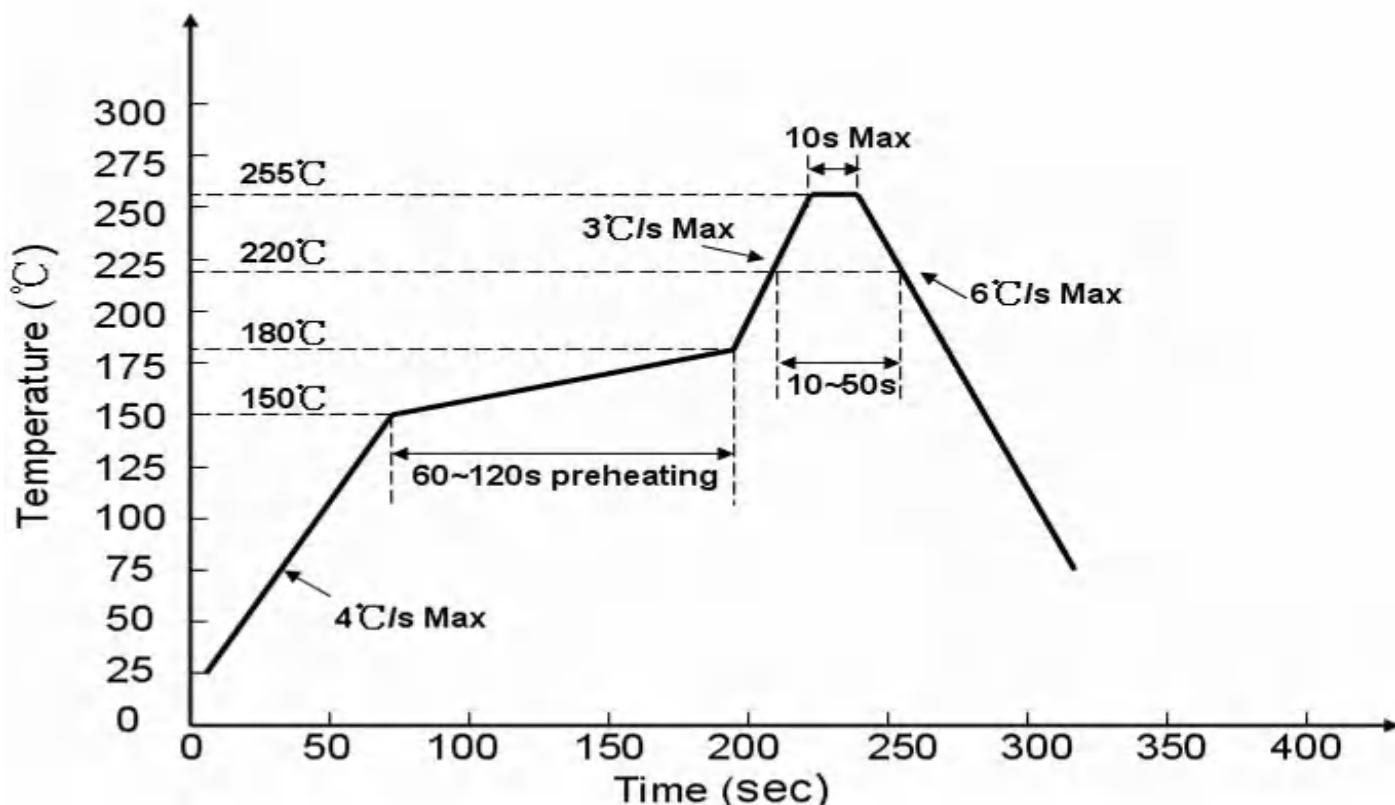
2、公差: 如无特别标注则为 ± 0.10 mm。

三、建议焊接温度曲线：

3.1、有铅制程：



3.2、无铅制程



四、参数指标；(Ta=25℃)

参数	符号	最大额定值			单位
		R	G	B	
功耗	P_d	75	76	76	Mw
最大脉冲电流	I_{FP}	70	70	100	mA
正向直流工作电流	I_F	5			mA
反向电压	V_R	5			V
工作环境温度	T_{opr}	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$			
储存环境温度	T_{stg}	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$			
焊接温度	T_{sol}	回流焊: $255^{\circ}\text{C} \times 8\text{s}$ 手动焊接: $300^{\circ}\text{C} \times 3\text{s}$			

 备注: I_{FP} 条件: 脉宽 $\leq 1\text{ms}$, 周期 $\leq 1/10$
五、光电参数；(Ta=25℃)

参数	符号/颜色		Min	Typ.	Max	单位	条件
光强	I _v	Red	80	--	180	mcd	V _{DD} =4.5V
		Green	380	--	550		
		Blue	80	--	160		
参考电压	V _{DD}	Red	3.0	4.5	5.0	V	--
		Green	3.0	4.5	5.0		
		Blue	3.0	4.5	5.0		
工作电流	I _{op}	/	--	5	--	mA	V _{DD} =4.5V
主波长	λ _d	Red	620	--	635	nm	
		Green	515	--	530		
		Blue	460	--	475		
频率误差范围	F _{tet}	/	--	±20%	--	Hz	
发光角度	2θ _{1/2}	/	--	140	--	deg	

 备注: 1. 发光强度公差 $\pm 10\%$

 2. 峰值波长公差 $\pm 2\text{nm}$

 3. 正向电压公差 $\pm 0.05\text{V}$

六、典型特性曲线；

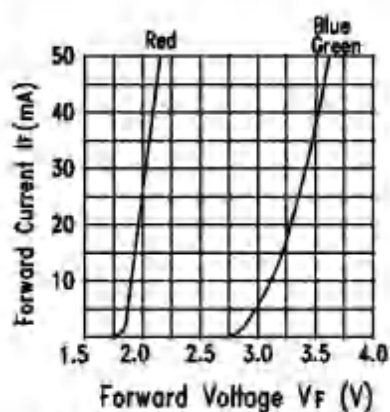
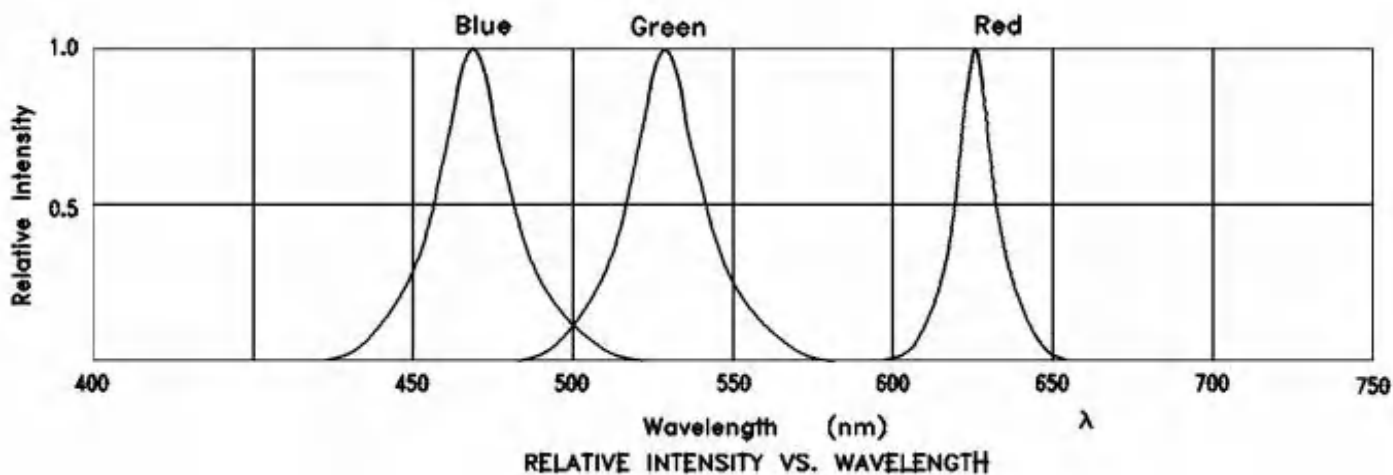


Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

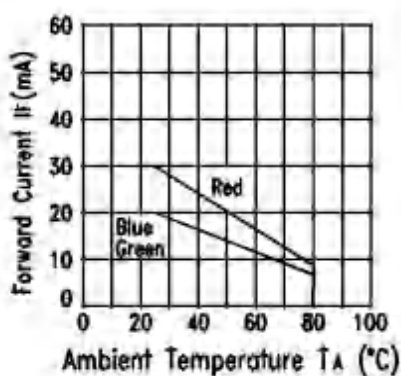


Fig.3 Forward Current Derating Curve

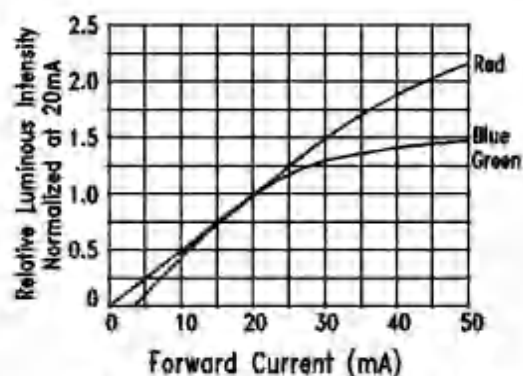


Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

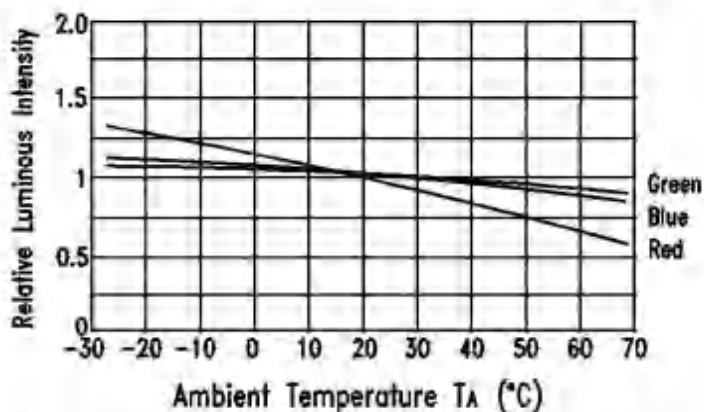


Fig.5 Luminous Intensity vs. Ambient Temperature

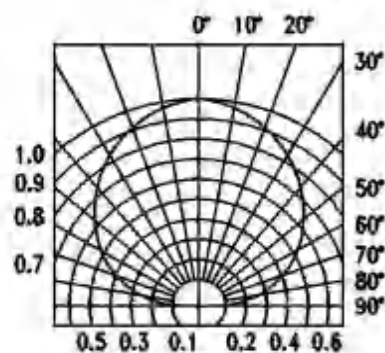


Fig.6 Spatial Distribution

注：如无另外注明，测试环境温度为 $25 \pm 3^\circ\text{C}$

● Tapping and packaging specifications(Units: mm)

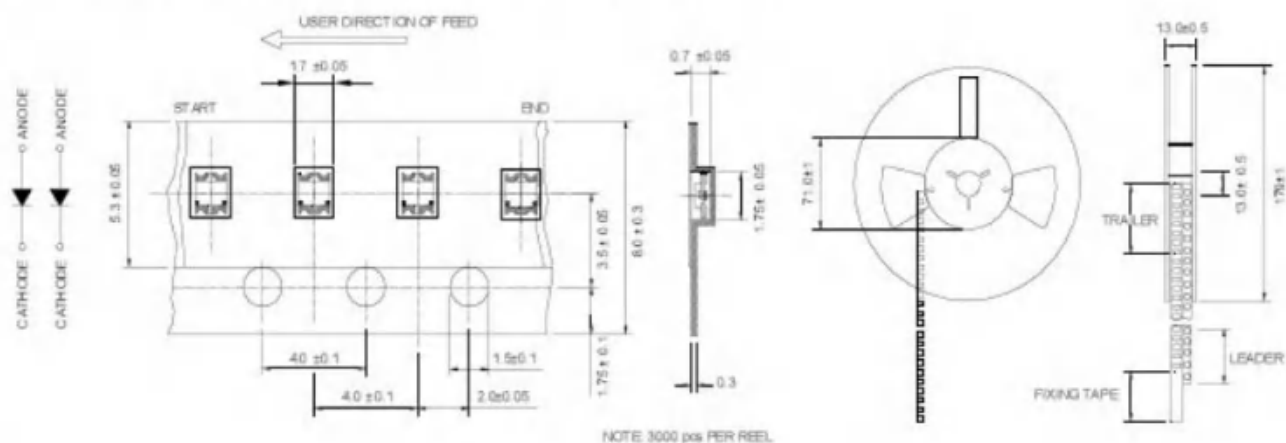


Figure 1 illustrates the packaging design of the product, showing the relationship between the reel, the aluminum foil bag, the box, and the carton.

- Reel:** The product is supplied in a reel of 3000 pieces.
- Aluminum Foil Bag:** The product is packaged in an aluminum foil bag with a bar code label. The bag dimensions are 220 mm (width) by 245 mm (height).
- Box:** The bags are packed in a box. The box dimensions are 185 mm (width) by 220 mm (depth) by 200 mm (height). The box contains 12 bags.
- Carton:** The boxes are packed in a carton. The carton dimensions are 470 mm (width) by 210 mm (depth) by 645 mm (height). The carton contains 6 boxes.

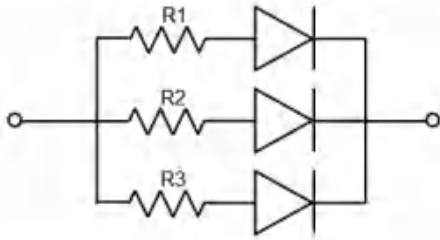
八、可靠性试验：

类别	测试项目	测试环境	测试时间	参考标准
耐久性测试	工作寿命	室温条件下以最大额定电流持续点亮； 以 20mA 测试。	1000 小时 (-24 小时, +72 小时)	MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1
	高温高湿储存	IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH= 85%	1000 小时 (± 2小时)	JESD22-A101
	高温储存	环境温度Ta= 105±5℃	1000 小时 (-24小时, +72小时)	MIL-STD-883D:1008 JIS C 7021:B-10
	低温储存	环境温度Ta= -55±5℃	1000 小时 (-24小时, +72小时)	JIS C 7021:B-12
环境测试	温度循环	105℃ ~ 25℃ ~ -55℃ ~ 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins	10 次循环	MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1010 JIS C 7021:A-4
	冷热冲击	IR-Reflow In-Board, 2 Times 85 ± 5℃ ~ -40℃ ± 5℃ 10mins 10mins	10 次循环	MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1011
	抗锡试验	焊锡温度 T.sol= 260 ± 5℃	10 ± 1secs 2 次	MIL-STD-202F:210 ^a MIL-STD-750D:2031 JIS C 7021:A-1
	红外回流焊 有铅制程	升温速度(183℃到最高值)：最大 3℃/秒 维持温度在 125(±25)℃：不超过 120 秒 维持温度在 183℃以上：60-150 秒 最高温度限制范围：235℃+5/-0℃ 维持在235℃+5/-0℃时间：10-30 秒 降温速度：最大 6℃/秒	-----	MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C
	红外回流焊 无铅制程	升温速度(217℃到最高值)：最大 3℃/秒 维持温度在 175(±25)℃：不超过 180 秒 维持温度在 217℃以上：60-150 秒 最高温度限制范围：260℃+0/-5℃ 维持在260℃+0/-5℃时间：20-40秒 降温速度：最大 6℃/秒	-----	MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C
	可焊性试验	焊锡温度 T.sol= 235 ± 5℃ 浸入速度：25±2.5 mm/秒 上锡率 ≥95% 焊盘面积	浸入时间：2±0.5 秒	MIL-STD-202F:208D MIL-STD-750D:2026 MIL-STD-883D:2003 IEC 68 Part 2-20

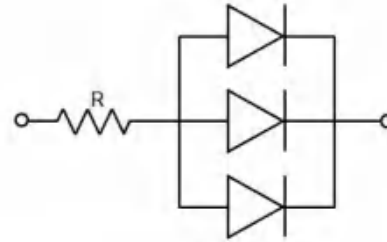
九、注意事项：

9.1 使用：

1. LED 是电流驱动元件，电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。
2. 为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致，建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示；如采用下图模式 B 所示电路，LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。



电路模式 A



电路模式 B

3. 过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能，所以为使 LED 有较好的性能表现应远离热源。
4. 光电参数公差：

正向电压 REF / VF: $\pm 0.02V$

亮度 CAT / IV: $\pm 11\%$

波长 HUE / WLD: $\pm 1nm$

9.2 存储：

1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为：温度: $5^{\circ}C \sim 30^{\circ}C$ ；湿度: 85%RH 以下。当库存超过两个月，使用前应做除湿处理，条件 $60^{\circ}C/8$ 小时。
2. 打开原始包装后，建议储存环境为： 温度 $5 \sim 30^{\circ}C$ ； 湿度 60% 以下。
3. LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内。
4. 打开包装后，元件应该在 168 小时（7 天）使用；且贴片后应尽快做焊接。
5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应作除湿处理。
烘烤条件: $60^{\circ}C$ ， 24 小时。

9.3ESD 静电防护：

LED（特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED）是静电敏感元件，静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大, VF 变低, 或者无法点亮等等。所以请注意以下事项：

1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。
2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护（接地阻抗值 10Ω 以内）。
3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品。
4. 建议在作业过程中，使用离子风扇来压制静电的产生。
5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。

9.4 清洗:

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED, 严禁使用腐蚀性溶液清洗。

9.5 焊接:

1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线。
2. 回流焊焊接不得超过两次。
3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应不超过 30W。
4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。
5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。

9.6 其他:

1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员。
2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。
3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。

特点

- ◆ VDD 输入电压：3.5V~5.5V
- ◆ OUT R/G/B 恒流值：5mA
- ◆ OUT R/G/B 上电状态：默认关闭
- ◆ OUT R/G/B 端口耐压：10V
- ◆ OUT R/G/B 输出灰度等级：256 级
- ◆ 采用单线归零码 SID 数据协议
- ◆ 同一帧显示数据同步刷新
- ◆ 数据串行级联传输，抗干扰能力强
- ◆ 信号传输速率：800Kbps
- ◆ 集成驱动幻彩光源专用内置 IC
- ◆ 支持 5050、3535 等灯驱一体封装

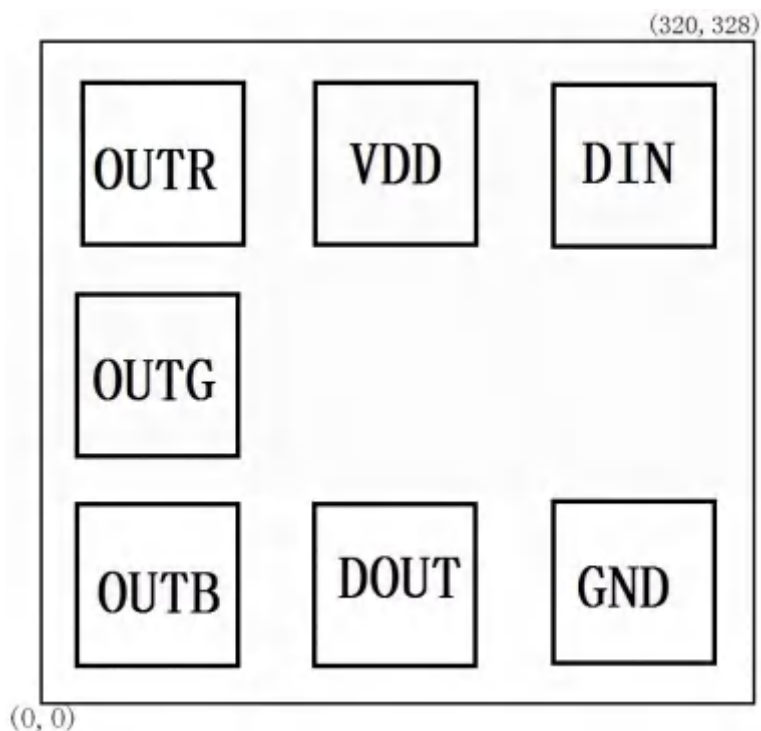
应用领域

- ◆ 幻彩软硬灯条、像素屏、异形屏、各种电子产品、电器设备显示灯
- ◆ 室内 LED 装饰照明、建筑 LED 外观/情景照明

概述

MW1838EA是单线传输的三通道LED驱动控制芯片，采用单线归零码SID数据协议。

OUT R/G/B端口默认输出电流5mA。



DIE 尺寸

X: 320um

Y: 328um

PAD 定义及功能说明

编号	PAD 名称	功能说明	PAD 坐标		PAD 类型	PAD 大小(um)
			X(um)	Y(um)		
1	VDD	电源输入端	160.00	267.8	邦定 PAD	80*80
2	GND	接地端	261.00	60.2	邦定 PAD	80*80
3	DIN	信号输入端	260.00	267.8	邦定 PAD	80*80
4	DOUT	级联信号输出端	161.00	60.2	邦定 PAD	80*80
5	OUTR	恒流驱动端口, 邦定到红灯或其他颜色灯珠负极	60.00	267.8	邦定 PAD	80*80
6	OUTG	恒流驱动端口, 邦定到绿灯或其他颜色灯珠负极	60.00	163.88	邦定 PAD	80*80
7	OUTB	恒流驱动端口, 邦定到蓝灯或其他颜色灯珠负极	60.00	59.96	邦定 PAD	80*80

说明:

OUTR/G/B PAD 分别邦定到红、绿、蓝灯珠负极, 客户也可根据实际需求, 选择邦定灯珠类型。

封装打线参考示意图

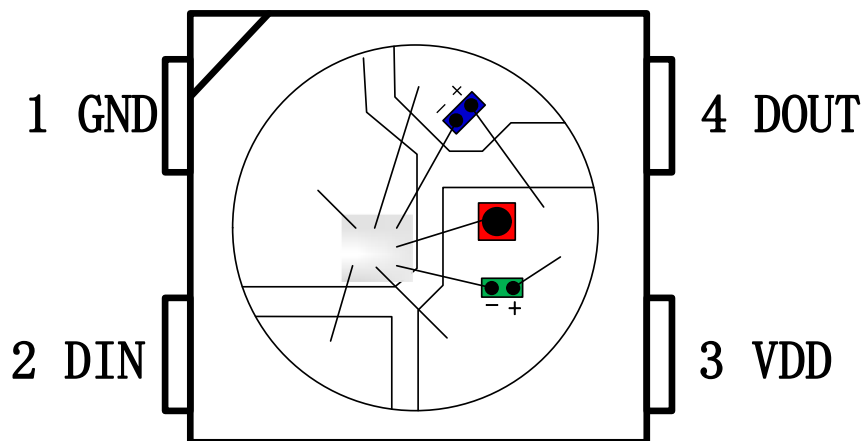


Fig. MW1838EA 封装打线参考示意图

说明:

- 1、以上仅为封装打线参考示意图，客户需根据实际的灯珠支架进行打线排布调整；
- 2、OUTR/G/B 端口邦定的灯珠类型，可根据客户实际需求进行邦定选择；
- 3、封装时必须按照 IC 及灯珠标注的正负极进行邦定，切不可将正负极邦反；
- 4、可封装 5050、3535 等封装形式的灯珠封装，客户可根据实际的灯珠框架及尺寸选择灯珠；

极限参数（注 1）

若无特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	参数	范围	单位
BV_{OUT}	OUT R/G/B 端口耐压	10	V
T_J	工作结温范围	-40~150	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}	存储温度范围	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
V_{ESD}	HBM 人体放电模式	>2	KV

注 1：超出最大极限值，芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。

电气工作参数（注 2、3）

若无特殊说明， $V_{DD}=5\text{V}$ ， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	芯片电源电压	-	3.5	-	5.5	V
I_{DD}	静态电流	$V_{DD}=5\text{V}$, I_{OUT} "OFF"	-	0.45	-	mA
V_{IH}	输入信号阈值电压	DIN 输入高电平	3.1	-	-	V
V_{IL}		DIN 输入低电平	-	-	1.5	V
I_{OH}	DOUT 输出电流	DOUT 输出高，串接 10Ω 电阻至	-	-14	-	mA
I_{OL}	DOUT 灌电流	DOUT 输出低，电源对 DOUT 灌电流	-	14	-	mA
V_{DS_S}	OUT R/G/B 恒流拐点电压	$I_{OUT}=5\text{mA}$	-	0.7	-	V
%VS. V_{DS}	OUT R/G/B 输出电流 变化量	$I_{OUT}=5\text{mA}$, $V_{DS}=1.0\sim 3.0\text{V}$	-	0.5	-	%
%VS. V_{DD}		$I_{OUT}=5\text{mA}$, $V_{DD}=4.5\sim 5.5\text{V}$	-	0.5	-	%
%VS. T_A		$I_{OUT}=5\text{mA}$, $T_A=-40\sim +85^{\circ}\text{C}$	-	5.0	-	%
I_{leak}	OUT R/G/B 端口漏电流	$V_{DS}=11\text{V}$, I_{OUT} "OFF"	-	-	1	μA

注 2：电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

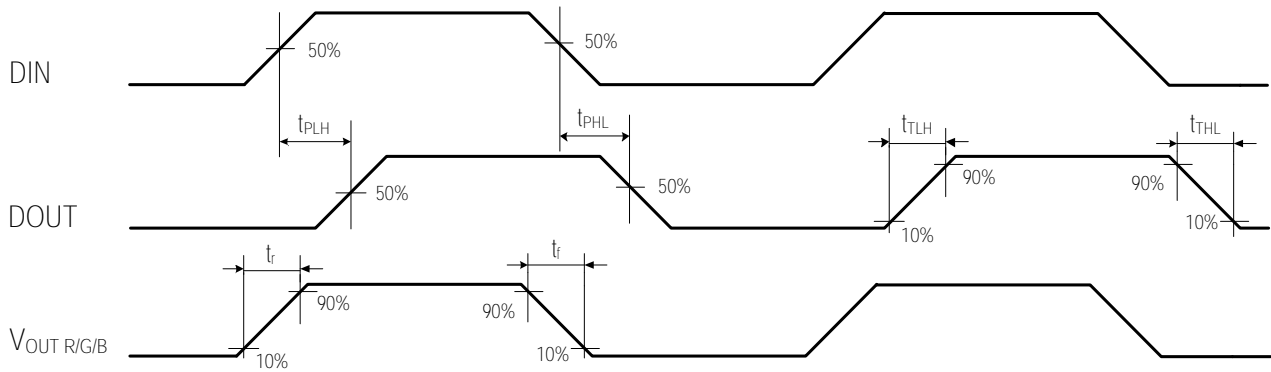
注 3：规格书的最小、最大参数范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。

开关特性

若无特殊说明， $V_{DD}=5\text{V}$ ， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
f_{PWM}	OUT R/G/B 输出 PWM 频率	$I_{OUT}=5\text{mA}$, OUT 端口串接 200Ω 电阻至 VDD	-	4.5	-	KHz
t_{PLH}	信号传输延迟（注 4）	DOUT 端口对地负载电容 30pF , DIN 至 DOUT 的信号传输延时	-	80	-	ns
t_{PHL}			-	80	-	ns
t_{TLH}	DOUT 转换时间（注 5）	DOUT 端口对地负载电容 30pF		12		ns
t_{THL}				10		ns
t_r	OUT R/G/B 转换时间（注 6）	$I_{OUT\ R/G/B}=5\text{mA}$, OUT R/G/B 端口串接 200Ω 电阻至 VDD, 对地负载电容 30pF	-	500	-	ns
t_f			-	500	-	ns

注 4、注 5、注 6：如下图所示



动态参数测试示意图

数据通信协议（注 7、8）

1、编码描述

MW1838EA 协议采用的是单极性归零码，每一个码元都必须有低电平。本协议的每个码元起始为高电平，高电平时间宽度决定“0”码或者“1”码。

输入码型：

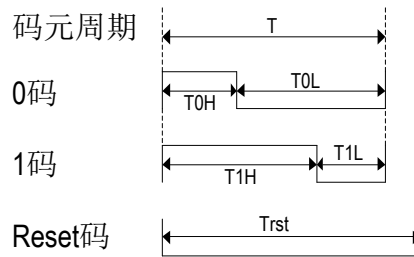


Fig. MW1838EA 归零码数据通信协议图

符号	参数	最小值	容差范围	单位
T	码元周期	1.2	-	us
T0H	0 码, 高电平时间	0.3	±0.05	us
T0L	0 码, 低电平时间	0.9	±0.05	us
T1H	1 码, 高电平时间	0.9	±0.05	us
T1L	1 码, 低电平时间	0.3	±0.05	us
Trst	Reset 码, 低电平时间	>200	-	us

注 7：写程序时，码元周期最低要求为 1.2us；

注 8：0 码、1 码的高电平时间需按照上表的规定范围，0 码、1 码的低电平时间要求小于 20us；

2、协议数据格式

Trst+第一颗芯片 24bits 数据+第二颗芯片 24bits 数据+.....+第 N 颗芯片 24bits 数据+Trst

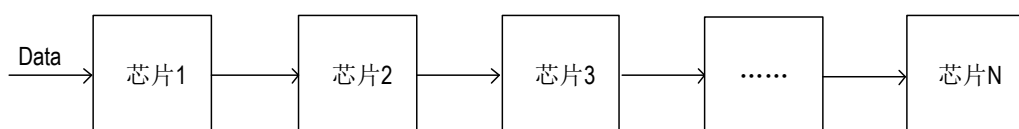
- 24bit 灰度数据结构：高位在前，按照 RGB 的顺序发送

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

bit23.....

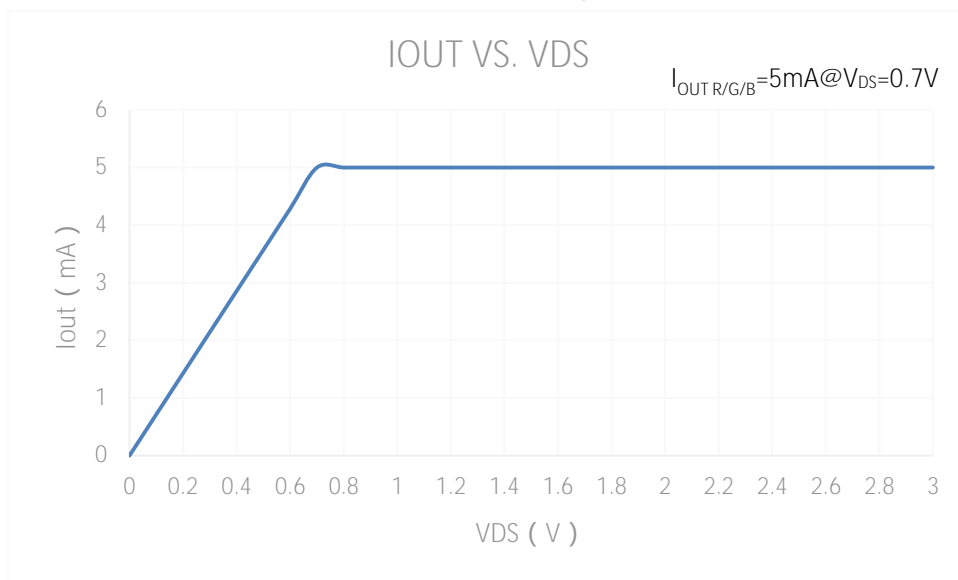
bit0

- 系统拓扑图：



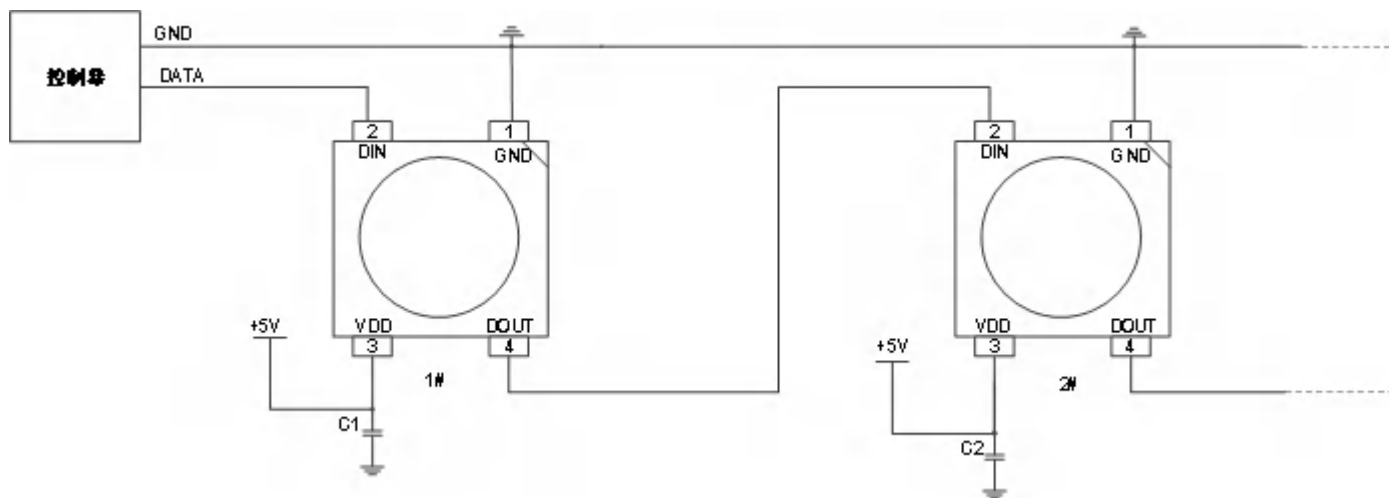
恒流特性

达到恒流拐点后，MW1838EA 输出电流不受 OUT 端口电压 V_{DS} 影响。



I_{OUT} 与 OUTR/G/B 端口电压 V_{DS} 的关系图

DC5V 应用方案



产品应用示意图

注：以上应用图中，C1、C2 为 100nF/16V 瓷片电容。